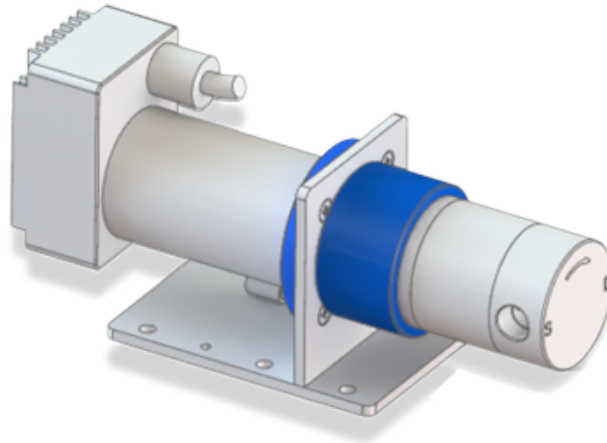


## Produktinformation

### Wärmedämmmodul · Ergänzungsmodule



#### Beschreibung

Mit dem Wärmedämmmodul lassen sich heiße Medien bis 150 °C fördern. Es beinhaltet eine thermisch dämmend ausgeführte Kupplungsbaugruppe aus Kunststoff (PEEK™) zwischen Pumpe und Antrieb. Die Wärmeübertragung von der Pumpe auf den temperaturempfindlichen Antrieb wird durch die Kunststoffabdeckung eingeschränkt. Eine Konvektionskühlung des Antriebs wird bei hohen Einschalt Dauern und Medientemperaturen empfohlen.

#### Patente und Marken

Mikrozahnringspumpen (und Gehäuse) sind durch erteilte Patente geschützt: EP 1 354 135 B1; US 7,698,818 B2; DE 10 2011 001 041 B4; CN 103 348 141 B; US 10,012,220 B2; CN 103 732 921 B; US 9,404,492 B2; US 6,520,757 B1.

HNPM®, mzi®, MoDoS®, µ-Clamp®, µDispense®, Centifluidic Technologies®, LiquiDoS®, smartDoS®, colorDoS® sind eingetragene deutsche Marken der HNP Mikrosysteme GmbH.

#### Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH  
Bleicherufer 25  
19053 Schwerin

T +49 385 52190-300  
F +49 385 52190-333  
sales@hnp-mikrosysteme.de

Stand 2023/06